

# 財務概況

このセクション(財務概況)における業績は断りがない限り、2005年3月期の数値を示しており、比較は、2004年3月期と行っております。

## 売上及び利益

### 事業環境

当期2005年3月期の世界経済動向は、原油価格高騰による材料・素材価格の上昇などの影響で減速傾向が懸念されましたが、米国経済は、大統領選挙に伴う景気刺激を背景に底堅い成長を示しました。アジア経済においては、中国が引続き高成長率を維持し、韓国や台湾におきましても、堅調に推移しました。また、日本経済は、個人消費や民間設備投資の増加などにより、総じて好調に推移しました。

当社の参画しているエレクトロニクス業界においては、アテネ五輪効果も加わり、DVDレコーダー、薄型テレビに代表されるデジタル家電の市場が、前期に引き続き活況を呈しました。また、パソコンの買い替え需要や携帯電話の第三世代への買い替え需要も牽引役となり、これらに搭載される半導体・FPD(フラット・パネル・ディスプレイ)などの市場は順調に推移し、シリコンサイクルの一つのピークが形成されるなど当社を取り巻く環境は好調でした。

### 会計方針の変更

当社(単独)は2005年3月期より、半導体製造装置及びFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から、原則として設置完了基準に変更いたしました。これは出荷から設置完了に至る期間の長期化傾

向が顕著になってきたこと、ならびに出荷後の業務プロセスの見直しにより設置完了に関するデータが整備されてきたことから、収益の実態をより適切に反映させることを目的としています。

また、当社(単独)は2005年3月期より、半導体製造装置及びFPD製造装置に係る保証期間中のアフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から、過去の支出実績を基準にして算出した見積額を製品保証引当金として計上することに変更いたしました。この変更は、過年度のアフターサービスにかかる費用の実績データが整備され蓄積されたこと、また、顧客満足度という観点からも当該アフターサービスの重要性が増してきており、アフターサービス費用を製品販売時の収益に対応させることによって期間損益の適正化を図るために行うものです。

### 事業区分の方法の変更

当社は、産業用エレクトロニクス製品の製造販売に従事しており、従来、販売形態から見て単一のセグメント区分としていましたが、2005年3月期より、製品・サービスの種類及び販売方法などの類似性を考慮して、「産業用電子機器」、「電子部品」の区分によるセグメント(事業)に変更しています。

この変更は、産業用電子機器事業の出荷から設置完了に至る期間の長期化傾向が顕著になってきたことから、2005年3月期において、産業用電子機器事業の収益の計上基準を、出荷基準から設置完了基準へ変更したことに伴い、当社の事業の実態をより適切に表示するために行ったものです。

## 新会計方針と旧会計方針による連結業績比較

	2004年3月期 旧会計方針	2005年3月期 旧会計方針(A)	前期比 増減	2005年3月期 新会計方針(B)	差異 (B-A)
売上高	¥529,654	¥716,666	35.3%	¥635,710	¥-80,956
産業用電子機器事業	445,425	630,417	41.5%	549,461	-80,956
半導体製造装置及びFPD製造装置	425,747	613,185	44.0%	532,229	-80,956
半導体製造装置	-	516,318	-	457,191	-59,127
FPD製造装置	-	96,867	-	75,038	-21,829
コンピュータ・ネットワーク	18,448	15,966	-13.5%	15,966	0
その他	1,230	1,266	3.0%	1,266	0
電子部品事業	84,229	86,249	2.4%	86,249	0
売上総利益	140,155	197,167	40.7%	175,913	-21,254
販売費及び一般管理費	117,875	112,007	-5.0%	111,930	-77
営業利益	22,280	85,160	282.2%	63,983	-21,177
その他収益(費用)	-7,344	4,284	-158.3%	-8,208	-12,492
税金等調整前当期純利益	14,936	89,444	498.9%	55,775	-33,669

(注)2004年3月期以前の半導体製造装置及びFPD製造装置の内訳の開示は行っておりません。なおコンピュータ・ネットワーク部門、電子部品事業には会計方針変更の影響はありません。

## 売上の状況

2005年3月期の連結売上高は、6,357億円となりました。旧会計方針において、比較すると前期比35.3%増、7,167億円となりました。

主力の半導体製造装置は、通信インフラの発展とともにパソコン、携帯電話、デジタル家電などの機器が高性能化してきており、搭載されるDRAM、フラッシュメモリ、システムLSI(大規模集積回路)の需要が拡大しました。このため、日本・韓国・台湾などアジアの半導体メーカーからの引き合いが活発化し、売上高は、4,572億円となりました。旧会計方針においては、5,163億円となりました。

また、FPD製造装置においては、液晶パネルメーカーが、低価格化と大量生産による薄型テレビの普及・拡大に向けて、戦略的に供給能力を拡大させるなか、売上高は、750億円となりました。旧会計方針においては、969億円となりました。

コンピュータ・ネットワーク部門は、前期比13.5%減少の160億円、電子部品部門は、前期比2.4%増の862億円となりました。

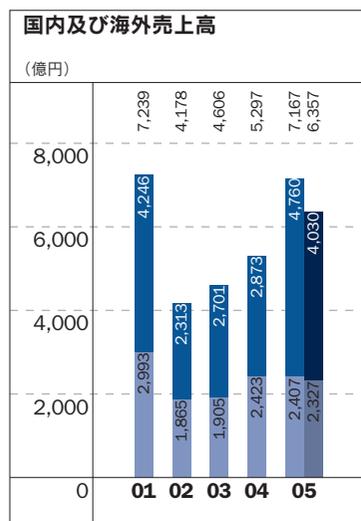
地域別では、国内売上高2,327億円となり、旧会計方針において、比較すると前期比0.7%減、2,407億円となりました。海外売上高は4,030億円となり、旧会計方針において、比較すると前期比65.7%増、4,760億円となりました。連結売上高に占める海外売上高の比率につきましては前期の54.2%から63.4%に増加しました。

また、当期の連結受注高は、前期比3.1%上昇し6,742億円となり、期末の受注残高は3,131億円となり、旧会計方針において、比較すると前期比15.5%減、2,322億円となりました。

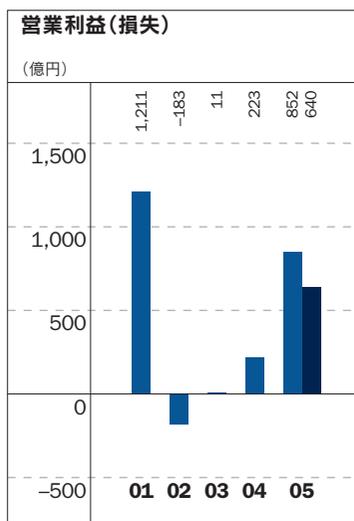
## 売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上原価は前期比18.0%増加の4,598億円、売上総利益は1,759億円となり、この結果、売上総利益率は27.7%となりました。旧会計方針において比較すると、売上原価は前期比33.4%増加の5,195億円、売上総利益は前期比40.7%増の1,972億円となりました。主な要因としましては、売上の増加及び半導体製造装置部門の売上総利益率の改善によるものです。

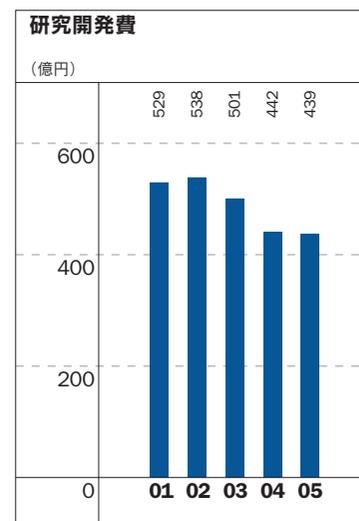
販売費及び一般管理費は、前期比5.0%減の1,119億円となり、売上高に対する比率は17.6%となりました。旧会計方針において、比較すると前期比5.0%減、1,120億円となり、売上高に対する比率は15.6%となりました。販売費及び一般管理費の主な減少要因は、前期実施した人員削減の影響などにより給料手当が22億円減少したこと、ならびに設備投資抑制により減価償却費が24億円減少したことなどによるものです。一般管理費に含まれる研究開発費は、前期比0.6%減の439億円、売上高に対する比率は6.9%となりました。



■ 国内(旧会計方針)  
■ 海外(旧会計方針)  
■ 国内(新会計方針)  
■ 海外(新会計方針)



■ (旧会計方針)  
■ (新会計方針)



これらの結果、営業利益は、640億円となりました。旧会計方針において、比較すると前期の223億円から629億円増加し、852億円となりました。

### その他収益(費用)及び当期純利益

その他の費用純額は、厚生年金基金の代行返上益71億円を計上したものの、事業整理損失28億円及び過年度の収益に対応する製品保証引当金繰入額125億円を計上したことなどにより、82億円の損失となりました。この結果、税金等調整前当期純利益は、558億円となりました。旧会計方針において、比較すると前期の149億円から745億円増加し、894億円となりました。

当期純利益は繰延税金資産に対する評価性引当金の戻入計上を行ったことにより法人税等調整額マイナス220億円を計上し、前期から533億円増加の616億円となりました。この結果、1株当たり当期純利益は343.63円(前期1株当たり当期純利益46.37円)となりました。配当金は、前期比35円増加の45円、配当性向は、連結ベースで13.1%、単独ベースで23.9%となりました。

### 部門別営業概況

#### 産業用電子機器事業

主力の半導体製造装置部門の売上が好調だったことにより、当セグメントの2005年3月期における売上高(他のセグメントへの内部売

上を含む)は、5,505億円となりました。新会計方針による売上総利益率は29.9%、営業利益は608億円、営業利益率は11.0%となりました。

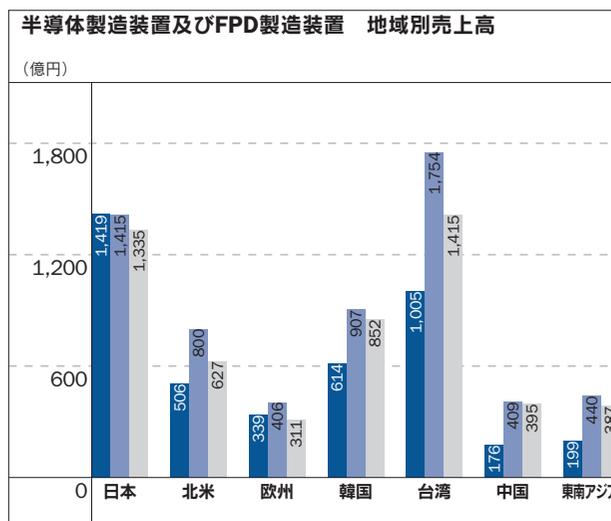
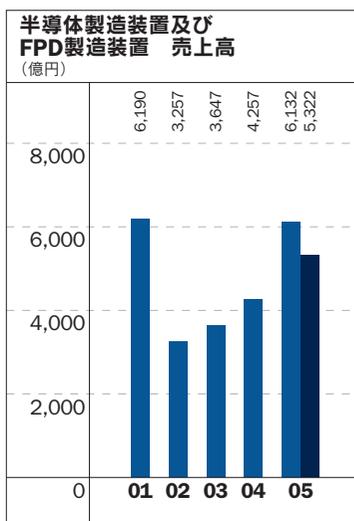
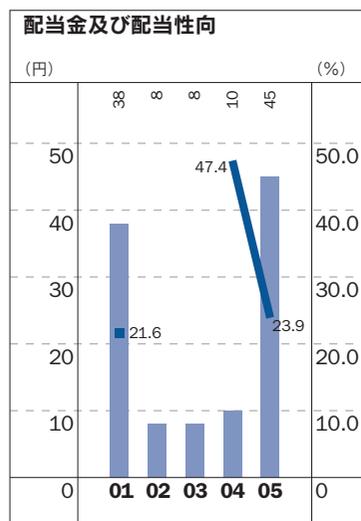
### 半導体製造装置及びFPD製造装置

#### 半導体製造装置

特に今回の景気回復の牽引役の一つであるデジタル家電に内蔵されるシステムLSI(大規模集積回路)に強い日本の半導体メーカーや、旺盛なDRAMやフラッシュメモリの需要に支えられ、活発に投資を行っている韓国・台湾の半導体メーカーからの引き合いが相次ぎました。こうした状況のもと、当部門の2005年3月期の売上高は4,572億円となりました。旧会計方針においては、5,163億円となりました。

装置別動向としましては、装置市場の拡大に伴い、コータ/デベロップ、エッチング装置、熱処理成膜装置、CVD装置、ウェーハローバ、洗浄装置など全ての主要製品において売上が増加しました。特に新製品としまして、新型の熱処理成膜装置「TELFORMULA™」、次世代対応のコータ/デベロップ「CLEAN TRACK™ LITHIUS™」、新型洗浄装置「EXPEDIUS™」などの販売を拡大しました。

ウェーハ口径別では多くの半導体メーカーが300mmウェーハ対応工場の投資に移行するなか、当社はこの分野に注力しました。この結果、装置本体の売上比率は約70%程度となっています。



2002年3月期及び2003年3月期の配当性向は単独ベースで当期純損失を計上したため掲載しておりません。

また、当部門の受注高は、5,105億円となり、期末の受注残高は2,362億円となりました。なお当部門の受注高、受注残高は2005年3月期より開示しております。

#### FPD製造装置

薄型テレビの普及及び市場の拡大に向けて、液晶パネルメーカー各社は戦略的に供給能力を拡大するなか、当社の製品であるドライ・プロセス装置、フォト・プロセス装置に対する引き合いも活発化しました。こうした状況のもと、当部門の2005年3月期の売上高は750億円となりました。

また、当部門の受注高は623億円、期末の受注残高は668億円となりました。なお、当部門の受注高、受注残高は2005年3月期より開示しております。

#### コンピュータ・ネットワーク

当部門につきましては、SAN(Storage Area Network:外部記憶装置間及び記憶装置とコンピュータの間を結ぶ高速なネットワーク)ソリューション、ネットワークソリューション及びブロードバンドソリューションの拡販に努めましたが、2005年3月期の売上高は前期比13.5%減少の160億円となりました。

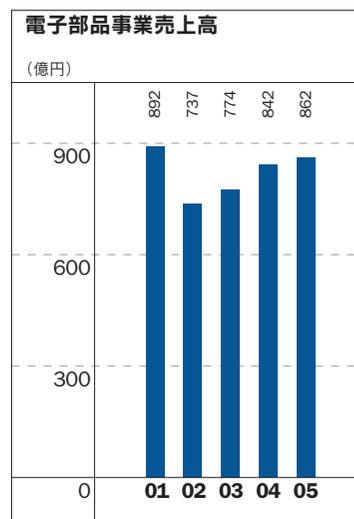
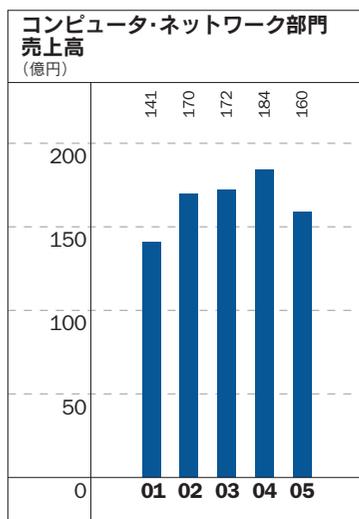
当部門の売上高の71%を占めるSAN関連製品では、ネットワーク構築の技術基盤であるファイバーチャネルスイッチ、ホストバスアダプタビジネスの売上は堅調に推移しました。また企業・個人情報漏洩防止の観点から、企業におけるネットワーク・セキュリティ対策が注目されておりますが、データ保護強化の需要を背景にADIC社の販売権獲得やバックアップ用高圧縮ディスク製品などの投入によりバックアップソリューションを強化するとともに、ストレージデータ暗号化製品の国内販売も開始しました。

ネットワーク関連製品では、安全性の高いWebサイト構築を可能にするF5 Networks社製品を中心にサイト構築ビジネスが堅調に推移しました。SSL-VPN(Secure Sockets Layer-Virtual Private Network)製品による安全なアクセスを可能にするネットワーク構築ビジネスが好調にスタートするとともに、迷惑メールや詐欺電子メールを遮断する新製品CipherTrust社の製品をラインナップに追加することにより法人向けビジネスにも進出しました。

また、当部門の受注高は、前期並みの165億円となり、期末の受注残高は前期比13.6%増の41億円となりました。

#### その他

当部門の2005年3月期の売上高につきましては、前期比3.0%増加の13億円となりました。また、当部門の受注高は、前期並みの13億円となりました。



## 電子部品事業(東京エレクトロニクス株式会社)

当セグメントは、子会社である東京エレクトロニクス株式会社が担っています。

当期の電子部品事業は、国内営業拠点を新たに3カ所(京都市・浜松市・三島市)開設し、全国16カ所の営業拠点による顧客に密着した営業活動を積極的に行いました。また、自社開発商品を「inrevium(インレビウム)」とブランド化し、市場ニーズを取り入れたIC、ボード、ソフトウェアなどを開発するとともに、カスタムICなどの設計を請負う設計受託業務の拡大に努めました。その結果、「半導体製品」、「ボード製品」、「ソフトウェア」、「一般電子部品」を取扱う電子部品事業の当期連結売上高(他のセグメントへの内部売上を含む)は、前期比2.7%増加の881億円となりました。売上総利益率は、前期の13.3%から13.2%、営業利益は、前期並みの31億円、営業利益率は、前期の3.7%から3.5%となりました。

また、当事業の受注高は、前期比3.0%減少の836億円となり、期末の受注残高は前期比30.3%減の61億円となりました。

電子部品事業の売上高の88%を占める「半導体製品」は、デジタル家電向け商品が一般的に堅調であり、そのなかでも技術力を要するASICなどのカスタムICが薄型テレビ(PDP・液晶)向けに伸長しました。また、携帯電話向け専用ICも引き合いが強かったことなどから、「半導体製品」の売上高は前年比2.9%増加しました。

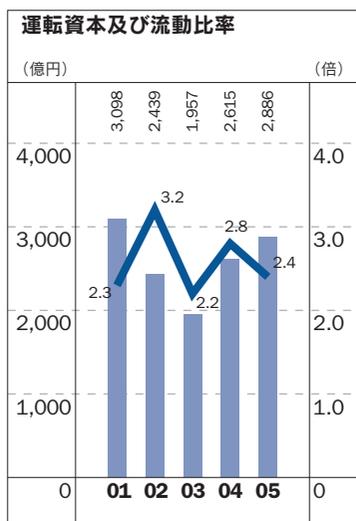
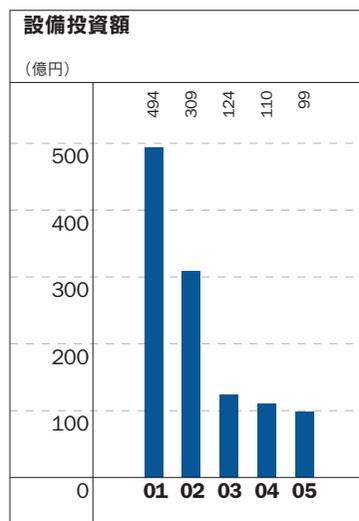
「ボード製品」は、FA関連装置向けPCマザーボードや通信機器向け音声処理ボードの販売が堅調であったことから、売上高は前年比11.0%増加しました。一方、「ソフトウェア」は、POS端末を中心とした組み込みシステム機器向けに各種OS、ツールの拡販に努めましたが、売上高は前年比9.1%減少し、「一般電子部品」も、スイッチング電源、液晶ディスプレイ、パネルPCなどを中心に拡販に努めましたが、売上高は前年比1.6%減少しました。

今後については、カスタムICなどの高付加価値商品の技術サポートを徹底することと、自社ブランド「inrevium(インレビウム)」商品の開発や設計受託業務を強化することで、顧客並びに仕入先から信頼される「ナンバーワン技術商社」を引き続き目指します。さらに、当期に設立した香港の現地法人が今4月から営業を開始するなど、国内はもとよりアジア・パシフィック地域での営業推進に努めます。

## 財政状態及びキャッシュ・フロー

### 財政状態

当期末の流動資産は、前期末から922億円増加し、4,952億円となりました。主な内容としましては、現金及び預金は売掛金の早期回収を進めたことなどにより728億円増加しました。受取手形及び売掛金は、売掛金の早期回収に努めたことと、収益の認識基準を出荷基準から設置完了基準に変更したことにより、売上高拡大基調にもかかわらず



■ 運転資本  
■ 流動比率

デット・エクイティ・レシオ =  
有利子負債 ÷ 期末株主資本

ず前期末から586億円減少しました。また、たな卸資産は、在庫圧縮の取り組みの成果が出たものの、収益の認識基準を変更したことにより、前期末から563億円増加しました。また、過去に計上した繰延税金資産に対する評価性引当金の戻入計上により繰延税金資産が153億円増加しました。資産回転日数は、構造改革による売上債権の早期回収によって、未収金を除く受取手形及び売掛金の回転日数(期末時点の売上高と売掛金で計算)は、前期末の159日から114日と改善、たな卸資産回転日数についても前期末の72日から56日と改善しました。(いずれも旧会計方針における期末時点の売上高で計算)

有形固定資産は、前期末から104億円減少の984億円となりました。これは主に、設備の減価償却が進んだことによるものです。なお、当期の設備投資額は評価用機械装置の取得による99億円がその主な内容です。

以上の結果、総資産は、前期末から827億円増加の6,443億円となりました。

流動負債は前期末から651億円増加し、2,066億円となりました。主な内容としては、収益認識基準の変更に伴う前受金が308億円、未払法人税等が101億円、1年以内償還予定社債が100億円それぞれ増加したこと、ならびにアフターサービス費用にかかる会計方針を変更したことに伴い製品保証引当金131億円を計上したことによるものです。

長期負債は、第9回無担保社債300億円が1年以内に償還を迎えることなどにより、前期末から393億円減少の1,011億円となりました。

株主資本につきましては、前期末から564億円増加し、3,322億円となり、株主資本比率は、前期末の49.1%から2.5ポイント増加の51.6%となりました。株主資本当期純利益率(ROE)は前期の3.1%から17.2ポイント増加の20.3%となりました。

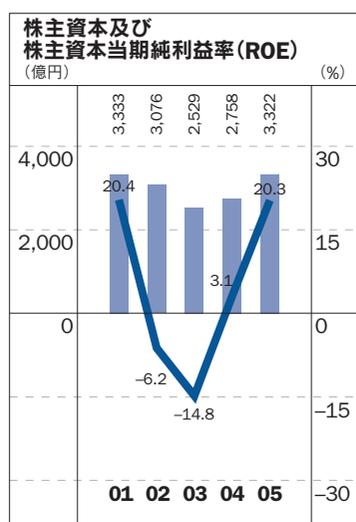
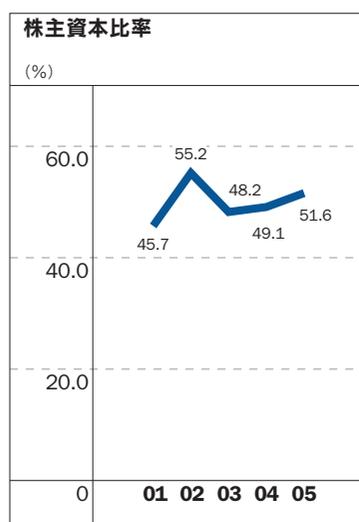
## キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前期の79億円のプラスに対し、1,144億円のプラスと大幅に増加いたしました。主な内容としましては、税金等調整前当期純利益558億円、減価償却費215億円及び前受金の増加308億円などがそれぞれキャッシュ・フローのプラスとなったことに加え、売掛金の早期回収など様々な取り組みの成果によるものであります。

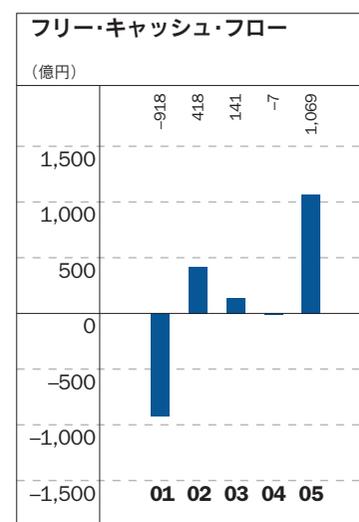
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前期のマイナス85億円に対してマイナス75億円となりました。主な内容としましては、研究開発用機械装置の取得による87億円の支出であります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、引き続き負債圧縮を進めており、第7回無担保社債200億円の償還、借入金の返済、配当金の支払などにより、前期のマイナス103億円から当期はマイナス343億円となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末の427億円から728億円増加の1,154億円となりました。



■ 株主資本  
■ 株主資本当期純利益率(ROE)



フリー・キャッシュ・フロー＝  
営業活動によるキャッシュ・フロー  
+ 投資活動によるキャッシュ・フロー

## 事業などのリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価などに影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。

### (1) 外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっております。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としておりますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約などによって為替リスクヘッジに努めております。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社の業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (2) 研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術などの最先端技術について積極的な研究開発投資及び研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれなどの影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (3) 半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置などのハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加などの発生により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (4) 特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品及び顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (5) 安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理などの各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しております。しかしながら、当社製品に関連する安全性などの問題により、顧客への損害発生、受注取消などが発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (6) 品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、及びレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用して頂くことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品であるなどの原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生するなどにより当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (7) 知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や知的財産権を回避する場合などがあるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (8) その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業におけるさらなる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社及び他業種企業と同様に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症などの不可抗力、金融・株式市場、政府などによる規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失などの影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。